

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 113年度行專訴字第64號

03 民國114年7月23日辯論終結

04 原 告 詠業科技股份有限公司

05 代 表 人 蘇開建

06 訴訟代理人 林怡芳律師

07 李貞儀律師

08 童啟哲專利師

09 輔 佐 人 周志伸

10 被 告 經濟部智慧財產局

11 代 表 人 廖承威

12 訴訟代理人 吳鴻鎮

13 參 加 人 潘玉芬

14 訴訟代理人 彭國洋律師

15 徐念懷律師

16 黃國彰律師

17 輔 佐 人 廖昱昌

18 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
19 3年10月15日經法字第11317305580號訴願決定，提起行政訴訟，
20 並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

21 主 文

22 一、訴願決定及原處分均撤銷。

23 二、訴訟費用由被告負擔。

24 事實及理由

25 甲、程序方面：

26 原告起訴聲明原為：「原處分及訴願決定均撤銷」；「被告
27 就公告第I363453號『微型天線』發明專利（下稱系爭專
28 利）舉發案（097144473N03）另為舉發不成立之處分」，嗣
29 變更為「原處分及訴願決定均撤銷」（卷一第14頁、第375
30 頁），核其所為係使其聲明更明確，並非訴之變更追加，自
31 應准許，合先敘明。

01 乙、實體方面：

02 壹、爭訟概要：

03 原告於民國97年11月18日以「微型天線」向被告申請發明專利，經編為第097144473號審查，准予專利，並發給發明第I
04 363453號專利證書（申請專利範圍共23項）。原告復於系爭
05 專利舉發（N02）案提出105年11月3日系爭專利申請專利範
06 圍更正本，經被告准予更正。嗣參加人潘玉芬於112年12月8
07 日以系爭專利請求項1、10、21有違核准時專利法第22條第1
08 項第1款及第4項之規定提起舉發。案經被告審查於113年5月
09 8日以（113）智專議(二)04059字第11320468090號專利舉發審
10 定書為「請求項1、10、21舉發成立，應予撤銷」之處分
11 （下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於113年10月1
12 5日以經法字第11317305580號訴願決定書予以駁回，原告不
13 服提起本訴。本院認判決之結果將影響參加人之權利或法律
14 上之利益，依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟（卷一第
15 325至326頁）。

17 貳、原告主張及聲明：

18 一、系爭專利請求項1「微型天線」之技術特徵應解釋為「微型
19 迴路天線」；「該第二電極層與該第一電極層具有部份對應
20 重疊」之技術特徵應解釋為「該第二電極層與該第一電極層
21 具有部份對應重疊來產生電容效應，進而激發出共振頻
22 率」，又「其中該第一電極層及該第二電極層在該基體上未
23 直接連接」之「未直接連接」用於描述「未實體及電性連
24 接」，系爭專利請求項1之技術特徵均未為證據1所揭露，具
25 有新穎性。系爭專利請求項21基於系爭專利請求項1相同理
26 由具有新穎性。

27 二、證據1至證據3與系爭專利屬於不同的天線技術領域，證據
28 1、2或證據1、3的天線原理不相同，彼此間因基本天線訊號
29 收發原理不同而無法互相參考，結構上無法結合實施，證據
30 1已實質隱含排除系爭專利請求項1「其中該第一電極層及該
31 第二電極層在該基體上未直接連接」的反向教示，勉強結合

01 亦無法達到系爭專利請求項1之技術特徵，系爭專利請求項1
02 具有進步性，系爭專利請求項21基於相同理由具有進步性。
03 證據1、4均與系爭專利屬於不同的天線技術領域，皆未揭露
04 系爭專利請求項10之「其中該第一電極層及該第二電極層在
05 該基體上未直接連接」之技術特徵，系爭專利請求項10具有
06 進步性。

07 三、聲明：原處分及訴願決定均撤銷。

08 參、被告答辯及聲明：

09 一、原告就系爭專利請求項1「微型天線」、「該第二電極層與
10 該第一電極層具有部份對應重疊」之限縮解釋，並非系爭專
11 利請求項1界定之技術特徵。證據1既已揭露系爭專利請求項
12 1之所有技術特徵，自足以證明系爭專利請求項1不具新穎
13 性，原告就系爭專利自行限縮解釋後再提出所謂之模擬結
14 果，並無公信力可言。

15 二、原告就系爭專利請求項1「該第一電極層及該第二電極層在
16 該基體上未直接連接」之限縮解釋，並非系爭專利請求項1
17 界定之技術特徵，且原告一再使用說明書及圖而非系爭專利
18 請求項與證據1比對，實有誤導之嫌。原處分已陳明證據1圖
19 3顯示其第一電極層12及該第二電極層24均經由第一電極層2
20 0連接至接地電極22，亦即證據1之第一電極層12及該第二電
21 極層24在該基體10上同樣未直接連接，與系爭專利請求項1
22 之「該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接」
23 的技術特徵完全相同，證據1已揭露該技術特徵，原告主張
24 無理由。原告所提之甲證5至甲證8並非本件舉發案原告所提
25 之相關證據，應不予論究。

26 三、聲明：駁回原告之訴。

27 肆、參加人陳述及聲明：

28 一、系爭專利請求項1之「微型天線」、「該第二電極層與該第
29 一電極層具有部份對應重疊」技術特徵並無任何用語得將之
30 解釋為「微型迴路天線」、「該第二電極層與該第一電極層
31 具有部份對應重疊來產生電容效應，進而激發出共振頻

01 率」，如此解釋無法為系爭專利說明書所支持，違反禁止讀
02 入原則，該「微型天線」泛指任何可收發無線訊號之小尺寸
03 天線，而證據1揭露天線裝置具有小尺寸，天線裝置連結至
04 少一訊號饋入線及至少一接地線，即為微型天線；其說明書
05 第5欄第47至51行亦揭示迴路重點部份可產生電容效應。再
06 者，系爭專利請求項1之「該第一電極層及該第二電極層在
07 該基體上未直接連接」技術特徵應解釋為「該第一電極層及
08 該第二電極層在該基體上未形成電性迴路」，蓋因只要第一
09 電極層與第二電極層在基體尚未形成電性迴路，即該第一電
10 極層與該第二電極層間重疊部分即可產生具有電容器功能。
11 證據1揭示第一電極層透過貫穿接點接地，而第二電極層直
12 接（未透過貫穿接點）接地，二者未直接連接；第一電極層
13 與第二電極層在基體上並未形成電性迴路，足以證明系爭專
14 利請求項1不具新穎性，證據1、2之結合或證據1、3之結合
15 自亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。又證據1已揭露
16 或教示系爭專利請求項21所載「一承載基板，該基體以該第
17 二電極層設置在該承載基板之上表面」技術特徵，足以證明
18 系爭專利請求項21不具新穎性，證據1、2之結合或證據1、3
19 之結合自亦足以證明系爭專利請求項21不具進步性。

20 二、證據1揭露系爭專利請求項10之中單個天線單元的整體特
21 徵，差別僅在於系爭專利請求項10額外揭露複數具導電性之
22 第二電極層、複數微波材質之基體以及複數具導電性之第一
23 電極層，證據4已揭露在一個承載基板上設置多個天線陣列
24 單元，習知技術之人很容易想到在同一裝置的承載基板上設
25 置多個天線單元，證據1、4之結合足以證明系爭專利請求項
26 10不具進步性。

27 三、聲明：駁回原告之訴。

28 伍、爭點（卷一第379頁）：

29 一、系爭專利請求項1要件編號1A之「微型天線」及要件編號1E
30 之「其中該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連
31 接」應如何解釋？

- 01 二、證據1是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？
- 02 三、證據1、2或1、3之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具
- 03 進步性？
- 04 四、證據1、4之組合是否足以證明系爭專利請求項10不具進步
- 05 性？
- 06 五、證據1是否足以證明系爭專利請求項21不具新穎性？
- 07 六、證據1、2或1、3之組合是否足以證明系爭專利請求項21不具
- 08 進步性？
- 09 陸、本院判斷：
- 10 一、應適用之法令：系爭專利申請日為97年11月18日，於101年3
- 11 月19日經審定准予專利（審定卷第46頁、第109頁），是系
- 12 爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時之99年8月25日修正
- 13 公布、同年9月12日施行之專利法（下稱核准時專利法）為
- 14 斷。核准時專利法第22條第1項規定：凡可供產業上利用之
- 15 發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：□
- 16 申請前已見於刊物或已公開使用者。□申請前已為公眾所知
- 17 悉者。同法條第4項規定：發明雖無第一項所列情事，但為
- 18 其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能
- 19 輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。
- 20 二、系爭專利技術分析：
- 21 (一)欲解決之先前技術問題：
- 22 隨著無線通訊產品追求小型化與造型，天線由外露式轉為內
- 23 嵌式隱藏設計，常見的單極天線(Monopole)雖簡單便宜但尺
- 24 寸難以有效縮減而不美觀，應用較廣的平面倒F型天線(PIFA)
- 25 雖可隱藏且頻寬較大，但兩者均屬電場天線，容易受近場
- 26 介電物質產生電抗效應影響而造成頻率失準，且鄰近元件亦
- 27 可能影響天線性能，導致天線收發訊號效率降低及雜訊升高
- 28 (系爭專利說明書第5頁，卷一第443頁)。
- 29 (二)欲解決問題之技術手段：
- 30 採用一微波材料製成之基體，該基體具有一第一表面及一相
- 31 對的第二表面，在該第一表面設置一導電性第一電極層，並

01 在該第二表面上設置一導電性第二電極層，利用該第一電極
02 層與該第二電極層以部份對應重疊之方式形成具有電容器作
03 用之夾層空間，藉此產生所需電容量以提昇天線電容量，進
04 而縮減天線尺寸及體積，其中該第一電極層用以連接一訊號
05 饋入線，而該第二電極層用以連接一接地線，使天線體能提
06 供訊號收發功能，並且透過改變基體體積厚薄大小或改變此
07 二電極層重疊面積的大小來調整電容量，以改變或修正天線
08 的共振頻率，同時此結構亦可將電流侷限在天線週遭，避免
09 感應電流在線路板上竄流造成干擾(系爭專利說明書第3至7
10 頁，卷一第441至445頁)。

11 (三)獲致之技術功效：

12 可有效降低天線尺寸及體積，具體積小、結構簡單、成本
13 低、方便大量生產的優點，同時仍具有良好收發訊號效率與
14 能力，並能侷限電流竄流現象、改善近場電抗效應造成的電
15 流損失、避免天線與附近介質體間產生干擾，且能輕易藉由
16 調整電容量或電極重疊面積來修正或改變天線的共振頻率，
17 亦可達成多頻訊號收發之目的(系爭專利說明書第6至11頁，
18 卷一第444至449頁)。

19 (四)系爭專利申請專利範圍(主要圖如附件一所示)：

20 原告於105年11月3日申請更正申請專利範圍，經審查准予更
21 正，已於106年12月21日公告在案。本件相關之系爭專利請
22 求項1、10、21內容如下(以下如未註記，所載「請求項」
23 均指系爭專利更正後請求項內容)：

- 24 1.請求項1：一種微型天線，其係連結至少一訊號饋入線及至
25 少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：至少一微波材
26 質之基體，其係具有相對之第一表面及第二表面；至少一具
27 導電性之第一電極層，其設在該基體之第一表面，該第一電
28 極層具有一第一端電極，該訊號饋入線以及該接地線係連結
29 該第一端電極而電性連結於該第一電極層；以及至少一具導
30 電性之第二電極層，其設在該基體之第二表面，該第二電極
31 層具有一第二端電極，該接地線係連結該第二端電極而電性

01 連結於該第二電極層，且該第二電極層與該第一電極層具有
02 部份對應重疊，其中該第一電極層及該第二電極層在該基體
03 上未直接連接。

04 2.請求項10：一種微型天線，其係連結至少一訊號饋入線及至
05 少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：一承載基板；
06 複數具導電性之第二電極層，設置在該承載基板上，該第二
07 電極層係供連結該接地線；複數微波材質之基體，分別具有
08 相對之一第一表面以及一第二表面，各該基體並以該第二表
09 面設置在一該第二電極層上；以及複數具導電性之第一電極
10 層，分別設置在一該基體之該第一表面，各該第一電極層與
11 相對該第二電極層部份對應重疊，且該第一電極層並供連結
12 一該訊號饋入線，其中該第一電極層及該第二電極層在該基
13 體上未直接連接。

14 3.請求項21：一種微型天線，其係連結至少一訊號饋入線及至
15 少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：至少一微波材
16 質之基體，其係具有相對之第一表面及第二表面；至少一具
17 導電性之第一電極層，其設在該基體之第一表面，該第一電
18 極層係供連結該訊號饋入線；至少一具導電性之第二電極
19 層，其設在該基體之第二表面，該第二電極層係供連結該接
20 地線，且該第二電極層與該第一電極層具有部份對應重疊，
21 其中該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接；
22 以及一承載基板，該基體以該第二電極層設置在該承載基板
23 之上表面。

24 三、舉發證據說明：

25 (一)證據1：西元2007年5月15日公告之美國第US7218282B2號「A
26 NTENNA DEVICE」專利案（技術內容及主要圖如附件二所
27 示）。

28 (二)證據2：西元2006年3月16日公開之美國第US2006/0055603A1
29 號「CONCEALED PLANAR ANTENNA」專利案（技術內容及主要
30 圖如附件三所示）。

01 (三)證據3：西元1990年10月31日公開之歐盟第EP0394960A1號
02 「A microstrip antenna」專利案（技術內容及主要圖如附
03 件四所示）。

04 (四)證據4：西元2000年2月1日公告之美國第US6020853號「MICR
05 OSTRIP PHASE SHIFTING REFLECT ARRAY ANTENNA」專利案
06 （技術內容及主要圖如附件五所示）。

07 (五)前揭證據公告或公開日期皆早於系爭專利申請日（西元2008
08 年11月18日），可為系爭專利之先前技術。

09 四、系爭專利請求項1之「微型天線」技術特徵應解釋為「物理
10 尺寸結構相對緊湊，且採平面化設計，適於整合進空間受限
11 的裝置（如行動電子裝置）中的天線」；「其中該第一電極
12 層及該第二電極層在該基體上未直接連接」技術特徵應解釋
13 為「在構成該微型天線核心部份的介電基體範圍內，位於該
14 基體第一表面上的第一電極層與位於該基體第二表面上的第
15 二電極層之間，不存在任何通過該基體本身的物理性連
16 接」：

17 (一)核准時專利法第56條第3項規定：發明專利權範圍，以說明
18 書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得
19 審酌發明說明及圖。而請求項之解釋應以請求項中所載之文
20 字為基礎，並得審酌說明書、圖及申請時之通常知識。解釋
21 請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且
22 與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另
23 有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請
24 求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、
25 圖及申請時之通常知識。

26 (二)系爭專利請求項1「微型天線」技術特徵之解釋：

27 1.依系爭專利說明書記載「本發明之又一目的係在提供一種微
28 型天線，其體積小、結構簡單……」、「用在無線通訊產品
29 上的小型化天線結構」、「有效降低天線尺寸及體積……可
30 將天線體積縮至更小」及「……二電極層20、30之端電極2
31 1、31設置位置則以配合行動電子裝置之實際需求為主」（系

01 爭專利說明書第6至8頁，卷一第444至446頁），可知系爭專
02 利所謂「微型天線」一詞顯係相對於其應用場景（如無線通
03 訊產品、行動電子裝置）和所採用之平面化、集成化的電極
04 設計，並強調天線物理尺寸的緊湊性，雖系爭專利說明書未
05 記載「微型」一詞的量化標準（即多少尺寸以下稱為微型），
06 但系爭專利說明書已明確記載其所適用的場景，綜觀系爭專
07 利說明書整體脈絡，「微型天線」最廣泛、合理且與說明書
08 一致之解釋應為「物理尺寸結構較傳統天線相對緊湊，且採
09 平面化設計，適於整合進空間受限的裝置（如行動電子裝
10 置）中的天線」，實較原告或參加人所為解釋更符合系爭專
11 利之技術思想與實際應用場景，亦較能體現系爭專利之發明
12 目的。

13 2.原告雖主張微型天線之解釋係限於「迴路天線」（卷二第288
14 頁）。惟系爭專利說明書通篇未記載「迴路天線」一詞，且
15 系爭專利之各圖亦未見任何與「迴路天線」相關電路結構，
16 原告前揭解釋所提之「迴路天線」即其電路圖係臨訟製作，
17 並不足採。

18 (三)系爭專利請求項1「其中該第一電極層及該第二電極層在該
19 基體上未直接連接」技術特徵之解釋：

20 依系爭專利說明書記載「本發明之又一目的係在提供一種微
21 型天線，其體積小、結構簡單……」（系爭專利說明書第6
22 頁，卷一第444頁）及「本微型天線與一線路板50結合時，就
23 如第二圖所示，第一電極層20之第一端電極21會與線路板50
24 的訊號饋入線51連結，第二電極層30之第二端電極31會與線
25 路板50之接地線52連結，因而具有訊號收發功效」（系爭專
26 利說明書第8頁，卷一第446頁），可知系爭專利請求項1用語
27 明確限定「未直接連接」的範圍是「在該基體上」，強調該
28 連接狀態是針對基體之特定元件，雖系爭專利並不排除第二
29 電極層藉由接地線52連接到通往外部線路板50上的接地電
30 極，最終可能在外部線路板50與第一電極層形成電性連接，
31 然此種外部連接是發生在基體之外，而不是在基體內部或表

01 面直接將兩個電極層短接。對所屬技術領域具通常知識者而
02 言，系爭專利核心技術在於利用第一電極層與第二電極層間
03 的電容效應，縮小天線體積的同時也能控制該天線之共振頻
04 率，若第一電極層與第二電極層在基體上存在直接物理性連
05 接，其電容效應勢必受到一定程度之破壞，顯悖於系爭專利
06 請求項1之發明目的。據上所述，參酌系爭專利說明書整體
07 脈絡，系爭專利請求項1之「其中該第一電極層及該第二電
08 極層在該基體上未直接連接」最廣泛、合理且與說明書一致
09 之解釋應為「在構成該微型天線核心部份的介電基體範圍
10 內，位於該基體第一表面上的第一電極層與位於該基體第二
11 表面上的第二電極層之間，不存在任何通過該基體本身的物
12 理性連接」，實較原告或參加人所為解釋更符合系爭專利之
13 技術思想與實際應用場景，亦較能體現系爭專利之發明目
14 的。

15 五、證據1不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

16 (一)系爭專利請求項1要件分析為：1.要件編號1A：一種微型天
17 線，其係連結至少一訊號饋入線及至少一接地線，以收發訊
18 號，該微型天線包括：至少一微波材質之基體，其係具有相
19 對之第一表面及第二表面；2.要件編號1B：至少一具導電性
20 之第一電極層，其設在該基體之第一表面，該第一電極層具
21 有一第一端電極，該訊號饋入線以及該接地線係連結該第一
22 端電極而電性連結於該第一電極層；以及；3.要件編號1C：
23 至少一具導電性之第二電極層，其設在該基體之第二表面，
24 該第二電極層具有一第二端電極，該接地線係連結該第二端
25 電極而電性連結於該第二電極層；4.要件編號1D：且該第二
26 電極層與該第一電極層具有部份對應重疊；5.要件編號1E：
27 其中該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接。

28 (二)證據1與系爭專利請求項1之技術比對：

29 1.證據1說明書第4欄第25至60行揭露「圖1展示了實施於一雙
30 面基板10上之一本發明天線裝置的實施例……圖1中所示之
31 本發明天線裝置主要包含兩個整合的IFA(倒F型天線)，其中

01 一個天線形成於基板10的頂側主表面10A，另一個則形成於
02 底側之主表面10B。一包含一開路端12A與一短路端12B之第
03 一輻射電極12，形成於該基板10對應於頂側的主表面10A
04 上。此外，一用於電氣饋送第一輻射電極12的饋電線14設置
05 於該主表面10A上。該饋電線14於一饋電點16處連接至該第
06 一輻射電極12。關於設置於頂側主表面10A上的金屬化結
07 構，亦即，設置於其上的電極與線路，請參閱圖2A，其表示
08 該基板10相關部分的頂側主表面10A的俯視圖。該第一輻射
09 電極12的短路端12B，經由一貫穿連接20，連接至形成於該
10 基板10與主表面10A相對之底側主表面10B上的一接地電極22
11 (在圖1中以影線方式繪示)。此相對主表面10B(圖1中的背
12 側)在圖2A中被繪示為來自上方的『透視影像』……如圖2B
13 中最佳所示，一包含一開路端24A與一短路端24B之第二輻射
14 電極24形成於該主表面10B上。該短路端24B連接至該接地電
15 極22。此外，一耦合導體26形成於該主表面10B上，其包含
16 連接至該接地電極22的一第一端，以及於一耦合點28處連接
17 至該第二輻射電極24的一第二端」。系爭專利請求項1要件
18 編號1A「微型天線」應解釋為「物理尺寸結構較傳統天線相
19 對緊湊，且採平面化設計，適於整合進空間受限的裝置(如
20 行動電子裝置)中的天線」之理由已如前述。證據1前開段
21 落(即第4欄第25至60行)揭露之「天線裝置」係一平面型天
22 線且用於筆記型電腦或行動電話等行動裝置(參證據1說明書
23 第3欄第30至40行)故符合本院對「微型天線」之解釋，可對
24 應系爭專利請求項1要件編號1A「一種微型天線」，其中
25 「饋電線14」可對應系爭專利請求項1要件編號1A「訊號饋
26 入線」；其中「接地電極22」可對應系爭專利請求項1要件
27 編號1A「一接地線」；其中「基板10」可對應系爭專利請求
28 項1要件編號1A「一微波材質之基體」；其中「頂側主表面1
29 0A」、「主表面10B」可分別對應系爭專利請求項1要件編號
30 1A「第一表面」及「第二表面」，故證據1已揭露系爭專利
31 請求項1要件編號1A「一種微型天線，其係連結至少一訊號

01 饋入線及至少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：至
02 少一微波材質之基體，其係具有相對之第一表面及第二表
03 面」之技術特徵。

04 2.證據1說明書前開段落(即第4欄第25至60行)揭露之「第一輻
05 射電極12」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「具導電性
06 之第一電極層」，其中「一饋電點16」可對應系爭專利請求
07 項1要件編號1B「第一端電極」；其中「接地電極22」可對
08 應系爭專利請求項1要件編號1B「接地線」，故證據1已揭露
09 系爭專利請求項1要件編號1B「至少一具導電性之第一電極
10 層，其設在該基體之第一表面，該第一電極層具有一第一端
11 電極，該訊號饋入線以及該接地線係連結該第一端電極而電
12 性連結於該第一電極層；以及」之技術特徵。

13 3.證據1說明書前開段落(即第4欄第25至60行)揭露之「第二輻
14 射電極24」可對應系爭專利請求項1要件編號1C「第二電極
15 層」，其中「耦合點28」可對應系爭專利請求項1要件編號1
16 C「第二端電極」；其中「接地電極22」可對應系爭專利請
17 求項1要件編號1C「接地線」，故證據1已揭露系爭專利請
18 求項1要件編號1C「至少一具導電性之第二電極層，其設在該
19 基體之第二表面，該第二電極層具有一第二端電極，該接地
20 線係連結該第二端電極而電性連結於該第二電極層」之技術
21 特徵。

22 4.證據1圖1、2A、2B顯示「第一輻射電極12」、「第二輻射電
23 極24」部分相互重疊，故證據1已揭露系爭專利請求項1要件
24 編號1D「且該第二電極層與該第一電極層具有部份對應重
25 疊」之技術特徵。

26 5.系爭專利請求項1要件編號1E「其中該第一電極層及該第二
27 電極層在該基體上未直接連接」應解釋為「在構成該微型天
28 線核心部份的介電基體範圍內，位於該基體第一表面上的第
29 一電極層與位於該基體第二表面上的第二電極層之間，不存
30 在任何通過該基體本身的物理性連接」之理由已如前述。證
31 據1說明書前開段落(即第4欄第25至60行)與圖1、2揭露之

01 「第一輻射電極12」之「一短路端12B」在「基板10」內部
02 經由一「貫穿連接20」與「第二輻射電極24」之「一短路端
03 24B」直接連接(參證據1圖2A、2B)，故不符合本院對「其中
04 該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接」之解
05 釋，無法對應系爭專利請求項1要件編號1E「其中該第一電
06 極層及該第二電極層在該基體上未直接連接」之技術特徵。

07 (三)依上所述，證據1並未揭露系爭專利請求項1要件編號1E之技
08 術特徵，故證據1並不足以證明系爭專利請求項1不具新穎
09 性。

10 (四)參加人稱證據1於Col. 4, Lines 44至60揭露：第一電極層12
11 透過接地線12B與20連接接地；而第二電極層24透過接地線2
12 4B與26連接接地。第一電極層12與第二電極層24分別通過各
13 各自的接地線接地，亦即，證據1當中第一電極層12與第二電
14 極層24僅係透過接地線12B與20、接地電極22、接地線24B與
15 26形成間接連接，證據1已揭露第一電極層12與第二電極層2
16 4並未直接連接，更未在基體10上直接連接而形成電性迴
17 路，故系爭專利請求項1技術特徵1E與證據1所揭露實質上均
18 無任何差異，若有差異，也僅在於文字的記載形式或能直接
19 且無歧異得知之技術特徵，證據1已揭露系爭專利請求項1之
20 特徵等情(卷一第291至292頁)。經查：

21 1. 審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包
22 含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含
23 的內容。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有
24 通常知識者參酌引證文件公開時之通常知識，能直接且無歧
25 異得知的內容。又引證文件中包含圖者，因圖僅屬示意圖，
26 若無文字說明，僅圖明確揭露之技術內容始屬引證文件有揭
27 露者；而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮
28 放產生差異者，亦可用為參考。

29 2. 證據1說明書雖未以文字揭露「第一輻射電極12」與「第二
30 輻射電極24」直接物理性連接，但若證據1圖2A及圖2B有明
31 確揭露者，亦足以視為證據1已揭露或可做為參考。由證據1

01 圖2A與2B可得知位於頂側主表面10A之「第一輻射電極12」
02 經過「基板10」之內部，透過「貫穿連接20」與另一主表面
03 10B上的「接地電極22」連接(證據1之圖1及圖2A)，而位於
04 另一主表面10B之「第二輻射電極24」亦透過「貫穿連接2
05 0」與「接地電極22」連接(參證據1之圖1及圖2B)，由於
06 「第一輻射電極12」與「第二輻射電極24」均連接至「貫穿
07 連接20」，故證據1已揭露「第一輻射電極12」與「第二輻
08 射電極24」在「基板10」範圍內直接物理性連接，是以參加
09 人所述(即第一輻射電極12與第二輻射電極24並非直接連接
10 而是間接連接)與事實不符，並不可採。

11 六、證據1、2或證據1、3之組合不足以證明系爭專利請求項1不
12 具進步性：

13 (一)證據1未揭露系爭專利請求項1要件編號1E之技術特徵理由已
14 如前述。查證據2揭露一種縮小尺寸的天線，其中包含用於
15 將射頻能量傳送至天線或自天線傳送之饋電電路一部
16 份……同軸電纜的外導體30連接至接地平面20，而同一電纜
17 的內導體25則連接至主動元件10(參證據2說明書第[0022]
18 段)，其中「主動元件10」及「接地平面20」在介電層15當
19 中並未直接連接，故可對應系爭專利請求項1要件編號1E
20 「其中該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連
21 接」之技術特徵。證據2雖已揭露系爭專利請求項1要件編號
22 1E之技術特徵，惟仍須進一步判斷，證據1與證據2之間是否
23 有結合動機。經查，證據1揭露之第一輻射電極12係透過直
24 接饋電，作為低頻段輻射單元，並形成激勵迴路產生磁場，
25 而第二輻射電極24主要透過感應磁耦合從第一輻射電極12獲
26 得能量，作為高頻段的獨立輻射單元。它本身不直接饋電，
27 而是被動地被激勵後進行輻射。其核心功能是作為第二個工
28 作頻段的天線元件(參證據1說明書第5欄第1行至第6欄第10
29 行)，其中第一輻射電極12和第二輻射電極24之間因重疊和
30 介電質存在而必然產生電容，但證據1技術核心係利用感應
31 耦合來實現雙頻操作，而電容效僅是伴隨的物理現象，證據

01 1並未強調以堆疊電極方式調整電容值以縮小天線尺寸。證
02 據2係使用高介電材料15降低具有固定物理尺寸的天線的諧
03 振頻率，如果要在一個固定的目標頻率下工作，使用該高介
04 電材料可以顯著縮小天線所需的物理尺寸，主要是因為高介
05 電材料縮短電磁波在天線周圍介質中的有效波長(參證據2說
06 明書第[0020]段)，故證據2用以縮小天線物理尺寸之手段在
07 於介電材料之選擇。據上所述，證據1、2雖皆為通訊天線之
08 技術領域，但證據1技術核心是利用電極間感應耦合來實現
09 雙頻操作，而證據2之技術核心係透過選擇介電材料達成天
10 線物理尺寸縮小，與天線之電極物理形狀之設計無關，故難
11 謂證據1、2之間具解決問題之共通性及功能或作用之共通
12 性，該發明所屬技術領域具通常知識者顯無動機結合證據
13 1、2之技術內容，故證據1、2之組合不足以證明系爭專利請
14 求項1不具進步性。

15 (二)證據1未揭露系爭專利請求項1要件編號1E之技術特徵理由已
16 如前述。查證據3揭露一種微帶天線，其結構包含一個輻射
17 導體(12/22/32)和一個接地導體13，兩者之間夾著一層介電
18 基板11，並透過一個饋線14連接到輻射導體上的一個饋電點
19 15(參證據3說明書第3欄第1行至第6欄第16行)，其中輻射導
20 體(12/22/32)及接地導體13在介電基板11中並未直接連接，
21 故可對應系爭專利請求項1要件編號1E「其中該第一電極層
22 及該第二電極層在該基體上未直接連接」之技術特徵。證據
23 3雖已揭露系爭專利請求項1要件編號1E之技術特徵，惟仍須
24 進一步判斷，證據1與證據3之間是否有結合動機。經查，證
25 據1揭露之第一輻射電極12係透過直接饋電，作為低頻段輻
26 射單元，並形成激勵迴路產生磁場，而第二輻射電極24主要
27 透過感應磁耦合從第一輻射電極12獲得能量，作為高頻段的
28 獨立輻射單元。它本身不直接饋電，而是被動地被激勵後進
29 行輻射。其核心功能是作為第二個工作頻段的天線元件(參
30 證據1說明書第5欄第1行至第6欄第10行)，其中第一輻射電
31 極12和第二輻射電極24之間因重疊和介電質存在而必然產生

01 電容，但證據1技術核心是利用感應耦合來實現雙頻操作，
02 而電容效僅是伴隨的物理現象，證據1並未強調以堆疊電極
03 方式調整電容值以縮小天線尺寸。證據3係使用輻射導體與
04 接地導體之間的間距在天線周邊區域大於中央區域的天線設
05 計。該設計透過增大主要輻射區域（周邊）的間距來改善與
06 自由空間的阻抗匹配並降低Q值，從而拓寬頻帶，同時保持
07 中央區域的間距較小以利於饋電點的阻抗匹配並抑制高次
08 模。此變化的間距可藉由改變介電基板厚度或使導體（輻射
09 或接地或兩者）呈非平面形狀（如錐形、球面）來實現（參
10 證據3圖3A至3D）。據上所述，證據1、3雖皆為通訊天線之技
11 術領域，但證據1技術核心是利用電極間感應耦合來實現雙
12 頻操作，而證據3技術核心係利用改變電極形狀擴展微帶天
13 線的操作頻寬而並非縮小天線尺寸，難謂證據1、3之間具解
14 決問題之共通性及功能或作用之共通性，該發明所屬技術領
15 域具通常知識者顯無動機結合證據1、3之技術內容，故證據
16 1、3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

17 七、證據1、4之組合不足以證明系爭專利請求項10不具進步性：

18 (一)系爭專利請求項10要件分析為：1.要件編號10A：一種微型
19 天線，其係連結至少一訊號饋入線及至少一接地線，以收發
20 訊號，該微型天線包括：一承載基板；2.要件編號10B：複
21 數具導電性之第二電極層，設置在該承載基板上，該第二電
22 極層係供連結該接地線；3.要件編號10C：複數微波材質之
23 基體，分別具有相對之一第一表面以及一第二表面，各該基
24 體並以該第二表面設置在一該第二電極層上；以及；4.要件
25 編號10D：複數具導電性之第一電極層，分別設置在一該基
26 體之該第一表面，各該第一電極層與相對該第二電極層部份
27 對應重疊，且該第一電極層並供連結一該訊號饋入線；5.要
28 件編號10E：其中該第一電極層及該第二電極層在該基體上
29 未直接連接。

30 (二)證據1、4與系爭專利請求項10之技術比對：

- 01 1.證據1說明書第4欄第25至60行揭露「圖1展示了實施於一雙
02 面基板10上之一本發明天線裝置的實施例……圖1中所示之
03 本發明天線裝置主要包含兩個整合的IFA(倒F型天線)，其中
04 一個天線形成於基板10的頂側主表面10A，另一個則形成於
05 底側主表面10B。一包含一開路端12A與一短路端12B之第一
06 輻射電極12，形成於該基板10對應於頂側的主表面10A上。
07 此外，一用於電氣饋送第一輻射電極12的饋電線14設置於該
08 頂側主表面10A上。該饋電線14於一饋電點16處連接至該第
09 一輻射電極12。關於設置於頂側主表面10A上的金屬化結
10 構，亦即，設置於其上的電極與線路，請參閱圖2A，其表示
11 該基板10相關部分的頂側主表面10A的俯視圖。該第一輻射
12 電極12的短路端12B，經由一貫穿連接20，連接至形成於該
13 基板10與頂側主表面10A相對之主表面10B上的一接地電極22
14 (在圖1中以影線方式繪示)。此相對主表面10B(圖1中的背
15 側)在圖2A中被繪示為來自上方的『透視影像』……如圖2B
16 中最佳所示，一包含一開路端24A與一短路端24B之第二輻射
17 電極24形成於該主表面10B上。該短路端24B連接至該接地電
18 極22。此外，一耦合導體26形成於該主表面10B上，其包含
19 連接至該接地電極22的一第一端，以及於一耦合點28處連接
20 至該第二輻射電極24的一第二端」，其中「天線裝置」可對
21 應系爭專利請求項10要件編號10A「一種微型天線」；其中
22 「饋電線14」可對應系爭專利請求項10要件編號10A「訊號
23 饋入線」；其中「接地電極22」可對應系爭專利請求項1
24 要件編號1A「一接地線」。惟證據1並未揭露任何元件可對應
25 系爭專利請求項10要件編號10A之「承載基板」，故證據1並
26 未揭露系爭專利請求項10要件編號10A全部技術特徵。
- 27 2.證據1雖揭露第二輻射電極層24，但證據1並未揭露該第二輻
28 射電極層為複數個，故證據1並未揭露系爭專利請求項10要
29 件編號10B「複數具導電性之第二電極層」之技術特徵。
- 30 3.證據1雖揭露一基板10，且一個天線形成於基板10的頂側主
31 表面10A，另一個則形成於底側主表面10B，但證據1並未揭

01 露該基板10為複數個，故證據1並未揭露系爭專利請求項10
02 要件編號10C「複數微波材質之基體」之技術特徵。

03 4.證據1雖揭露第一輻射電極12，形成於該基板10對應於頂側
04 主表面10A上，但證據1並未揭露該第一輻射電極12為複數
05 個，故證據1並未揭露系爭專利請求項10要件編號10D「複數
06 具導電性之第一電極層」之技術特徵。

07 5.證據1前開說明書段落與圖揭露之「第一輻射電極12」之
08 「一短路端12B」在「基板10」內部經由一「貫穿連接20」
09 與「第二輻射電極24」之「一短路端24B」直接連接(參證據
10 1圖2A、2B)，故無法對應系爭專利請求項10要件編號10E
11 「其中該第一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連
12 接」之技術特徵。

13 6.證據1未揭露系爭專利請求項10「複數具導電性之第一電極
14 層」、「複數具導電性之第二電極層」及「複數微波材質之
15 基體」理由已如前述，證據1揭露之天線係「倒F型天線(IF
16 A)」天線，適用於行動電話、筆記型電腦等輕薄尺寸裝置之
17 通訊(參證據1說明書第3欄第31至35行)，其所包含之第一輻
18 射電極12係透過直接饋電，作為低頻段輻射單元，並形成激
19 勵迴路產生磁場，而第二輻射電極24主要透過感應磁耦合從
20 第一輻射電極12獲得能量，作為高頻段的獨立輻射單元。它
21 本身不直接饋電，而是被動地被激勵後進行輻射。其核心功
22 能是作為第二個工作頻段的天線元件(參證據1說明書第5欄
23 第1行至第6欄第10行)，其中第一輻射電極12和第二輻射電
24 極24之間因重疊和介電質存在而必然產生電容，但證據1之
25 技術核心是利用感應耦合來實現雙頻操作，而電容效僅是伴
26 隨的物理現象，並未強調以堆疊電極方式調整電容值以縮小
27 天線尺寸。證據4揭露一種微帶相移反射陣列天線技術，適
28 用於大型雷達系統(參證據4說明書第1欄第15至17行)，雖然
29 證據4所揭露之具導電性的微帶貼片(12/32/62/82)具複數
30 個，且天線整體呈現矩陣方式排列該複數個微帶貼片(參證
31 據4圖1、2)，但證據4核心技術在於實現電子相移和波束掃

01 描，透過控制每個天線單元上短截線(stubs)的連接狀態來
02 改變反射相位，完全與改變天線之電容值並最終達到天線小
03 型化目的無關。雖然在描述圖4的實施方式時，提到了將貼
04 片62和短截線64分置於多層基板的不同面，可以讓「天線單
05 元可以更緊密地放置在一起以增加天線的緊湊性(compactne
06 ss)(參證據4說明書第5欄第61行)，然而，此處「緊湊性」
07 指的是陣列中單元的排列密度，因為貼片和短截線分開布置
08 減少干擾或所需空間，使得單元間距可以縮小，並非指縮小
09 天線單元本身的物理尺寸。據上所述，證據1、4所揭露之天
10 線種類不相同，所使用之核心技術也不相同，且所欲裝載之
11 裝置亦不相同，難謂具解決問題之共通性及功能或作用之共
12 通性，該發明所屬技術領域具通常知識者顯無動機結合證據
13 1、4之技術內容，故證據1、4之組合不足以證明系爭專利請
14 求項10不具進步性。

15 八、證據1不足以證明系爭專利請求項21不具新穎性：

16 (一)系爭專利請求項21要件分析為：1.要件編號21A：一種微型
17 天線，其係連結至少一訊號饋入線及至少一接地線，以收發
18 訊號，該微型天線包括：至少一微波材質之基體，其係具有
19 相對之第一表面及第二表面；2.要件編號21B：至少一具導
20 電性之第一電極層，其設在該基體之第一表面，該第一電極
21 層係供連結該訊號饋入線；3.要件編號21C：至少一具導電
22 性之第二電極層，其設在該基體之第二表面，該第二電極層
23 係供連結該接地線，且該第二電極層與該第一電極層具有部
24 份對應重疊；4.要件編號21D：其中該第一電極層及該第二
25 電極層在該基體上未直接連接；以及；5.要件編號21E：一
26 承載基板，該基體以該第二電極層設置在該承載基板之上表
27 面。

28 (二)證據1與系爭專利請求項21之技術比對：

29 1.證據1說明書第4欄第25至60行揭露「圖1展示了實施於一雙
30 面基板10上之一本發明天線裝置的實施例……圖1中所示之
31 本發明天線裝置主要包含兩個整合的IFA(倒F型天線)，其中

01 一個天線形成於基板10的頂側主表面10A，另一個則形成於
02 底側主表面10B。一包含一開路端12A與一短路端12B之第一
03 輻射電極12，形成於該基板10對應於頂側的主表面10A上。
04 此外，一用於電氣饋送第一輻射電極12的饋電線14設置於該
05 主表面10A上。該饋電線14於一饋電點16處連接至該第一輻
06 射電極12。關於設置於主表面10A上的金屬化結構，亦即，
07 設置於其上的電極與線路，請參閱圖2A，其表示該基板10相
08 關部份的頂側主表面10A的俯視圖。該第一輻射電極12的短
09 路端12B，經由一貫穿連接20，連接至形成於該基板10與主
10 表面10A相對之主表面10B上的一接地電極22(在圖1中以影線
11 方式繪示)。此相對主表面10B(圖1中的背側)在圖2A中被繪
12 示為來自上方的「透視影像」……如圖2B中最佳所示，一包
13 含一開路端24A與一短路端24B之第二輻射電極24形成於該主
14 表面10B上。該短路端24B連接至該接地電極22。此外，一耦
15 合導體26形成於該主表面10B上，其包含連接至該接地電極2
16 2的一第一端，以及於一耦合點28處連接至該第二輻射電極2
17 4的一第二端」，其中「天線裝置」可對應系爭專利請求項2
18 1要件編號21A「一種微型天線」；其中「饋電線14」可對應
19 系爭專利請求項21要件編號21A「訊號饋入線」；其中「接
20 地電極22」可對應系爭專利請求項21要件編號21A「一接地
21 線」；其中「基板10」可對應系爭專利請求項21要件編號21
22 A「一微波材質之基體」；其中「頂側主表面10A」、「主表
23 面10B」可分別對應系爭專利請求項21要件編號21A「第一表
24 面」及「第二表面」，故證據1已揭露系爭專利請求項21要
25 件編號21A「一種微型天線，其係連結至少一訊號饋入線及
26 至少一接地線，以收發訊號，該微型天線包括：至少一微波
27 材質之基體，其係具有相對之第一表面及第二表面」之技術
28 特徵。

29 2.證據1說明書前開段落(即第4欄第25至60行)揭露之「第一輻
30 射電極12」可對應系爭專利請求項21要件編號21B「具導電
31 性之第一電極層」，其中「第一輻射電極層12」與「饋電線

01 14」連接可對應系爭專利請求項21要件編號21B「該第一電
02 極層係供連結該訊號饋入線」，故證據1已揭露系爭專利請
03 求項21要件編號21B「至少一具導電性之第一電極層，其設
04 在該基體之第一表面，該第一電極層係供連結該訊號饋入
05 線」之技術特徵。

06 3.證據1說明書前開段落(即第4欄第25至60行)揭露之「第二輻
07 射電極24」可對應系爭專利請求項21要件編號21C「第二電
08 極層」，該「第二輻射電極24」與「接地電極22」連接，其
09 中「第一輻射電極層12」與「第二輻射電極24」部分重疊，
10 故證據1已揭露系爭專利請求項21要件編號21C「至少一具導
11 電性之第二電極層，其設在該基體之第二表面，該第二電極
12 層係供連結該接地線，且該第二電極層與該第一電極層具有
13 部份對應重疊」之技術特徵。

14 4.證據1說明書前開段落揭露「第一輻射電極12」之「一短路
15 端12B」在「基板10」內部經由一「貫穿連接20」與「第二
16 輻射電極24」之「一短路端24B」直接連接(參證據1圖2A、2
17 B)，故無法對應系爭專利請求項21要件編號21D「其中該第
18 一電極層及該第二電極層在該基體上未直接連接；以及」之
19 技術特徵。

20 5.證據1並未揭露任何元件可對應系爭專利請求項21要件編號2
21 1E之「承載基板」，故證據1並未揭露系爭專利請求項21要
22 件編號21E「一承載基板，該基體以該第二電極層設置在該
23 承載基板之上表面」之技術特徵。

24 (三)依上所述，證據1並未揭露系爭專利請求項21要件編號21D、
25 21E之技術特徵，故證據1並不足以證明系爭專利請求項21不
26 具新穎性。

27 九、證據1、2或證據1、3之組合不足以證明系爭專利請求項21不
28 具進步性：

29 (一)證據1未揭露系爭專利請求項21要件編號21D、21E之技術特
30 徵理由已如前述。又證據2、3亦均未揭露任何元件可對應系
31 爭專利請求項21要件編號21E「承載基板」，故證據1至3均

01 未揭露系爭專利請求項21要件編號21E「以及一承載基板，
02 該基體以該第二電極層設置在該承載基板之上表面」之技術
03 特徵。

04 (二)證據1、2雖皆為通訊天線之技術領域，證據1技術核心係利
05 用感應耦合來實現雙頻操作，而電容效僅是伴隨的物理現
06 象，證據1並未強調以堆疊電極方式調整電容值以縮小天線
07 尺寸。證據2係使用高介電材料15降低具有固定物理尺寸的天
08 線的諧振頻率，如果要在一個固定的目標頻率下工作，使
09 用該高介電材料可以顯著縮小天線所需的物理尺寸，主要是
10 因為高介電材料縮短了電磁波在天線周圍介質中的有效波長
11 (參證據2說明書第[0020]段)，故證據2用以縮小天線物理尺
12 寸之手段在於介電材料之選擇。據上所述，證據1、2雖皆為
13 通訊天線之技術領域，但證據1技術核心是利用電極間感應
14 耦合來實現雙頻操作，而證據2之技術核心係透過選擇介電
15 材料達成天線物理尺寸縮小，與天線之電極物理形狀之設計
16 無關，故難謂證據1、2之間具解決問題之共通性及功能或作
17 用之共通性，該發明所屬技術領域具通常知識者顯無動機結
18 合證據1、2之技術內容，故證據1、2之組合不足以證明系爭
19 專利請求項21不具進步性。

20 (三)證據1、3雖皆為通訊天線之技術領域，但證據1技術核心是
21 利用電極間感應耦合來實現雙頻操作，而證據3技術核心係
22 利用改變電極形狀擴展微帶天線的操作頻寬，難謂證據1、3
23 之間具解決問題之共通性及功能或作用之共通性，該發明所
24 屬技術領域具通常知識者顯無動機結合證據1、3之技術內
25 容，故證據1、3之組合不足以證明系爭專利請求項21不具進
26 步性。

27 柒、綜上所述，爭點所示證據及證據組合不足以證明系爭專利請
28 求項1與請求項21不具新穎性及進步性、系爭專利請求項10
29 不具進步性，系爭專利並無違反核准時專利法第22條第1
30 項、第4項規定，被告所為「請求項1、10、21舉發成立，應
31 予撤銷」之處分，有所違誤，訴願決定予以維持，亦有未

01 合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，即無不合，應予准
02 許。

03 捌、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，核與本院判
04 決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

05 玖、據上論結，原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第
06 2條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

07 中 華 民 國 114 年 9 月 9 日

08 智慧財產第一庭

09 審判長法官 汪漢卿

10 法官 蔡惠如

11 法官 陳端宜

12 以上正本係照原本作成。

13 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
14 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
15 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
16 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
17 他造人數附繕本）。

18 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
19 逕以裁定駁回。

20 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
21 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
22 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

23

| 得不委任律師 為訴訟代理人 之情形 | 所 需 要 件 |
|---|--|
| (一)符合右列情 形之一者， 得不委任律 師為訴訟代 理人 | 1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代 理人具備法官、檢察官、律師資格或 為教育部審定合格之大學或獨立學院 公法學教授、副教授者。 |

| | |
|--|---|
| | <p>2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。</p> <p>3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。</p> |
| <p>(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人</p> | <p>1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。</p> <p>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。</p> <p>3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。</p> <p>4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。</p> |
| <p>是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。</p> | |

02 中 華 民 國 114 年 9 月 9 日

03 書記官 吳祉瑩